



电子元器件行业：供应链库存 或于23H1 重回健康水平 半导体 23H2 开始复苏



事项：全球晶圆代工龙头台积电 2022 年财报解读

长城科技观点

1、台积电 22Q4 营收环比下降 1.5%，符合预期，毛利率环比提升 1.8pct。

22Q4 台积电营收 199.3 亿美元(原指引 199 亿美元~207 亿美元)，，环比小幅下降 1.5%，符合预期；毛利率 62.2%，环比提升 1.8pct，净利率 47.3%，环比提升 1.5pct，主要受益于有利的汇率和成本改善。

2、台积电指引 23Q1 营收中值环比下降 14%，毛利率中值环比下降 7.7pct。

台积电前瞻指引 23Q1 营收区间 167 亿美元~175 亿美元，中值 171 亿美元，环比下降 14%；毛利率区间 53.5%~55.5%，环比下降 6.7pct~8.7pct，主要归因于终端市场需求疲软和客户库存调整。

3、汽车/HPC 领域需求保持强劲，22 年全年汽车/HPC 营收增速排名前二。

22Q4 按下游应用领域分类，其他/HPC/汽车领域营收环比增速排名前三，分别为 28%/10%/10%。22 年全年来看，汽车及 HPC 领域需求强劲，营收分别同比增长 74%/59%。

4、台积电 22Q4 5nm 制程营收占比提升至 32%，23 年 N3 制程将贡

献总营收的中个位数。22Q4 台积电 5nm 占总营收的 32%(22Q3 占 28%)，7nm 占 22%。N3 制程已于 22Q4 成功量产，预计 23 年将贡献中个位数营收，N3E 将于 23H2 实现量产，并计划 25 年量产 N2 制程。

5、地缘政治影响下，台积电积极布局全球建厂，美国 Fab1 计划于 24 年生产 N4 制程。美国亚利桑那州工厂已完成首批机台设备迁机，Fab1 计划于 2024 年生产 N4 制程，Fab2 计划于 2026 年生产 N3 制程；日本工厂制程为 12/16nm 和 20/28nm，计划于 2024 年底实现量产。

6、台积电预计 23H1 供应链库存到达底部，半导体 23H2 开始复苏。台积电预计 23H1 半导体供应链库存将大幅减少，重回健康水平，并指出半导体周期将在 23H2 开始复苏。

7、静待消费电子需求反转，看好“龙头低估”企业。半导体龙头公司在行情来临时，有望获得较好的 Beta 收益，重点关注卓胜微(射频芯片)、韦尔股份(CMOS 图像传感器)、闻泰科技(IDM+手机 ODM+光学模组)、北京君正(车规级芯片)、时代电气(功率半导体)等。

风险提示：下游需求不及预期，地缘政治因素，疫情风险，估值风险等

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51735

